

证券代码：300480

证券简称：光力科技

光力科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20210520

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中金公司：李学来；国华基金：王璠；百瑞信托：宋中原；点石汇鑫：刘世洋；宏科创投：张焱；洛阳创投：杨凯；金和基金：赵贺峰。
时间	2021年5月20日下午 15:00-17:00
地点	公司310会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：曹伟；ADT 总经理：张鹏；投资总监：田金钟；证券事务代表：关平丽；证券事务助理：倪艳丽
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司郑州航空港区半导体智能制造产业基地项目建设进展如何？</p> <p>答：公司郑州航空港区半导体智能制造产业基地一期工程已于2020年9月正式开工建设，近期主体即将封顶，预计2021年10月实现主体工程完工。</p> <p>公司正在加快推进半导体产业基地建设，力争早日投入使用，实现半导体装备国产批量化生产供货，夯实公司发展基础，促进公司长远发展。</p> <p>2、公司半导体装备目前生产模式是什么？</p> <p>答：公司半导体设备主要采用订单式与计划式相结合的生产方式，根据客户订单并结合市场预测情况合理安排生产。</p> <p>3、公司生产的半导体切割划片设备与国际一流产品的性能相比如何？有什么优势？</p> <p>答：公司本土化研制的6230、8230、6110等系列切割划片产品集合了LP、ADT的多年的技术积累和应用经验，在高端精密切割划片设备</p>

领域拥有世界一流的技术水平。同时公司是全球行业内既有切割划片机设备，又有高性能空气主轴的两家公司之一，综合竞争优势突出。

公司最新研制并推向市场的全自动型号划片机都将在国内本土化生产，将会充分发挥中国本土化生产优势，如成本、售后服务等优势。

4、ADT收购完成并表后，海外市场如何布局？

答：ADT 公司是一家全球化公司，已经拥有行业领先的技术优势及经验丰富的优秀技术和管理人才，拥有成熟的全球化销售网络，客户遍布全球主要市场。并购后公司将充分利用其全球化的销售渠道，加快公司产品在全球市场的销售推广，同时公司还将投入更多资源拓展全球市场，持续完善和加快全球化市场营销和服务网络建设，加快业务发展。

5、公司半导体设备市场需求情况如何？

答：2020 年底开始，芯片荒席卷全球。除了汽车领域，消费电子、物联网等市场也出现不同程度的芯片荒，预计短时间内芯片短缺现象难以得到缓解。旺盛的市场需求拉动半导体行业快速发展，半导体行业包括封测厂家都在加速进行产能扩张建设。半导体设备是半导体产业的上游，是半导体产业发展的基础，半导体产业的快速发展带动上游设备快速增长。

半导体切割划片设备同样面临供不应求，设备紧缺的情况。公司近些年相继推出多款半导体切割划片设备，已获得国内多家主流封测企业的 DEMO 和订单，开始进入客户正常生产流程，2021 年陆续实现销售供货。面对旺盛的市场需求及国产替代趋势，公司正在加班加点组织生产供货，以满足客户急迫的设备需求。

6、半导体行业是技术密集型行业，人才至关重要，高端人才引进是否会受到地域限制，会不会在行业聚集地建立研发中心或公司？

答：公司已是一家全球化公司，在中国、英国、以色列均设有研发中心和工厂，在英国、以色列、美国、菲律宾、中国台湾等均设立子公司及办事处；在国内郑州、上海、苏州、成都、南通等城市设有子公司。为了进一步拓展业务，引进并留住中高端人才，公司还考虑在不同区域和城市进一步布局，同时实施股权激励等各类人才激励方案，广泛吸引

	<p>中高端人才、留住核心人才。同时，除了自我发展外，也会积极借助“外力”，通过与国内外高校科研院所合作的方式，进一步提升公司研发能力。</p> <p>7、公司传统业务与半导体装备新兴业务是否具有协同性？</p> <p>答：公司传统业务对半导体业务具有综合协同效应，尤其是传统业务的技术创新能力具有明显的赋能作用。</p> <p>在财务方面，公司传统业务行业竞争优势明显，盈利能力较强，过去几年持续为公司的并购、研发、生产、市场开拓等提供资金支持。</p> <p>在技术方面，半导体新产品研发及国产化落地方面能够快速推进、取得好的成效，得益于传统安全生产监控装备领域常年累积的软硬件技术平台和管理平台发挥的综合优势，半导体业务与传统业务共享技术平台、传统业务相关技术在半导体业务成功实现跨界应用，在产品性能提升和成本控制方面发挥了重要作用。</p> <p>在人才方面，传统业务经过多年的持续发展和实践积淀，拥有一支富有创新能力、经验丰富、稳定高效的经营管理和技术团队，为公司半导体封测装备新兴业务输送大量的优秀人才，输出了管理经验，切实为半导体封测装备新兴业务快速发展提供了有力支撑。</p> <p>8、公司定增事项什么时间可以落地？</p> <p>答：公司向特定对象发行股票事项 2021 年 1 月 26 日已获得证监会批复，目前各项工作都在积极推进中，公司将在批复有效期内择机发行。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 5 月 20 日